



2023年7月25日

各 位

会 社 名 三益半導体工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 細 谷 信 明  
(コード番号 8155 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 専務取締役 八 高 達 郎  
管理本部担当  
(TEL. 027-372-2011)

## 固定資産の取得（新工場棟の建設）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り固定資産の取得（新工場棟の建設）を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取得の理由

今後の半導体市場の拡大に鑑み、現工場の隣接地に300mm シリコンウエハー専用工場棟を建設することにいたしました。

#### 2. 取得資産の内容

(1) 対象資産の内容	300mm 最先端シリコンウエハー製造用建屋・ユーティリティ設備
(2) 所在地	群馬県高崎市保渡田町
(3) 建築面積	11,283 m <sup>2</sup>
(4) 取得予定額	770 億円
(5) 資金計画	自己資金及び外部資金調達の手配

#### 3. 取得の日程

(1) 取締役会決議日	2023年7月25日
(2) 着工日	2023年8月予定
(3) 竣工日	2025年7月予定

#### 4. 今後の見通し

2024年5月期の業績に与える影響はございません。

以 上